

美国洛德Lord电子元器件导热胶

产品名称	美国洛德Lord电子元器件导热胶
公司名称	沈阳市源望化工橡胶有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国洛德
公司地址	辽宁沈阳市大东区汽车工业城,东北大马路汽配瑞城
联系电话	13109865536

产品详情

美国洛德lord电子元器件导热胶 详情见阿里巴巴我司官网<https://shop1377479812994.1688.com>

在电子材料领域有超过40年的丰富经验，我们的高性能电子材料被广泛应用于以下各类电子产品中：
电子灌封材料 我们可提供各类环氧树脂、有机硅及聚氨脂类灌封材料。环氧灌封胶：符合ul认证、低模量、耐高温、高导热，用于普通灌封、点火线圈灌封、电源模块灌封、磁感线圈灌封、各类传感器灌封等。有机硅灌封胶：符合ul认证、低模量、低粘度、高导热(0.8-3.2w/mk)用于普通灌封、电源模块灌封、各类传感器灌封等。聚氨脂灌封胶：适合各类电子电器产品的灌封。 产品 粘度(cps) 混合比例 (重量比) 固化条件 硬度 强度(psi) 特性 circalok 6007 r: 15,000 h: 80-105 100:5.5 16小时25 2小时65 85d 8,400 高导热率，高强度，低放热，低收缩率，通过ul94-v0认证。 circalok 6035 10,000 100:100 24小时25 2小时65 75d 5,000 高导热率，中等强度，通过ul94-v0认证，有红色和绿色可供选择。 300 2,000-40,000 100:7-100:100 24小时25 2小时100 65d-90d 2,200-9,800 可混合得到不同的硬度和强度。 340 7,000-60,000 100:3.5-100:7.0 24小时25 2小时150 90d-95d 6,300-9,400 高导热率，中等强度，通过ul94-v0认证。 600 1,200-10,000 100:14-100:100 24小时25 2小时100 60d-92d 2,300-10,900 可混合得到不同的硬度、强度和颜色，符合食品安全认证。 ep-809 2,800 100:32 16小时90 + 2小时125 92d 11,500 适合高压汽车电子点火线圈。 ep-830 4,000 100:28 3小时100 + 2小时150 97d 12,300 适合汽车电子点火线圈，粘接强度高。 es-111 6,000 100:29 2.5小时90 2小时140 >90d ---- 适用于高压汽车电子点火线圈，优异的耐高压和热冲击的性能。 产品 粘度(cps) 混合比例 (重量比) 固化条件 硬度 cte (ppm) 强度(psi) 热导率 特性 circalok 6702 30,000 100:100 16-24小时80 65a - 600 1.46 导热灌封，红色，高导热率，耐热冲击，通过ul94-v0认证 circalok 6703 8,000 100:100 4小时65 60a 220 600 0.8 电子元件导热灌封，低模量，良好的绝缘性能，灰色，通过ul94-v0认证。 circalok 6705 2,500 100:100 2小时65 60a 100 300 0.4 电子元件灌封，低粘度，良好的绝缘性能，黑色，通过ul94-v0认证。 sc-309 3,500 100:100 15分钟100 10分钟120 45a 190 50 1.0 电子元件导热灌封，低模量，低粘度，良好的绝缘性能，黑色，通过ul94-v0认证。 sc-320 35,000 100:100 60分钟125 60a 110 300 3.2 电子元件导热灌封，粉红色，高导热率，耐热冲击，通过ul94-v0认证。 产品 颜色 粘度(cps) 混合比例 (重量比) 固化条件 硬度 强度(psi) 特性 ur-312 透明 1,500 100:55 2小时25 15分钟85 50a 50 低模量，适合压敏感元件灌封。适合电子模块封装。 ur-322 透明 750 100:107 30分钟25 12a 100 低模量，低粘度，快速固化。适合电气/电子器件封装。 ur-325 黑色 4,000 100:25 24小时25 70a 770 高强度，良好的热稳定性。适合电气/电子器件的封装。 ur-340 黑色 500 100:104 24小时25 35a 63 低粘度，适合电气/电子器件封装。 微电子材料 我们提供单组份/双组份，导电/绝缘，

高导热性，快速固化、低温固化，芯片粘接材料。可用于led、cob或各类ic封装的粘接。产品粘度 (cps) 使用寿命 固化条件 体积电阻 (ohm - cm) tg () 特性 md-140 30,000 14天 10分钟120 3分钟180 0.00009 82 适合高功率led及芯片粘接，高导热率，快速固化。 md-161 40,000 5天 60分钟150 0.001 ----- 低粘度，适合细间距快速点胶。 我们提供符合消费级或半导体级要求的包封材料，具有操作简单、高可靠性、低应力等特点，可用于邦定芯片包封、智能卡包封或元器件固定。 顶部填充 产品粘度 (cps) 使用寿命 固化条件 硬度 (shore) cte (ppm) 特性 ep - 937 50,000 7天 30小时150 60分钟120 88d 35 消费级环氧树脂包封材料，快速固化，中等包封高度。 me - 430 300,000 24小时 30分钟150 94d 19 半导体级环氧树脂包封材料。 围边及填充 产品粘度 (cps) 固化条件 cte (ppm) tg () 特性 me-455 23,000 30分钟150 19 135 填充材料，快速固化。 me-456 1,100,000 30分钟150 19 135 围边材料，快速固化。 底部填充 产品粘度 (cps) 固化条件 cte (ppm) tg () 特性 me-525 6,000 15分钟165 30分钟150 alpha1-23 alpha2-85 120 适合高端陶瓷封装和汽车电子的应用场合，小尺寸芯片的底部填充。 me-531 4,000 30分钟150 15分钟165 alpha1-21 alpha2-85 140 适合消费级和pcb应用场合，小尺寸芯片的底部填充。 me-532 3,000 90分钟150 60分钟165 alpha1-32 alpha2-100 135 适合大尺寸、细间距芯片的底部填充。 me-541 35,000 90分钟150 60分钟165 alpha1-32 alpha2-100 145 适合大尺寸、细间距芯片的底部填充。 me-542 20,000 90分钟150 60分钟165 alpha1-30 alpha2-120 135 高导热底部填充。 me-543 21,000 90分钟150 60分钟165 alpha1-27 alpha2-95 135 超高导热，底部填充，可过无铅回流焊。 我们提供适应于线路板及芯片散热（导热）用途的各类导热胶、导热凝胶和导热脂。 导热胶 我们提供环氧类、有机硅类、特殊树脂类导热胶，具有常温/低温固化，高强度，高导热率，导电/非导电性，适合各类不同材料的粘接用于散热片、倒装芯片、变压器、大功率led等有散热要求的应用。 产品 颜色 固化条件 工作寿命 导热率 (w/mk) 强度 (lap shear) 特性 circalok 6037 黑色 绿色 24小时25 2-3小时 >1 25mpa 双组分导热胶，室温固化，高粘接强度，适合不同材料的粘接。 circalok 6151 灰色 30分钟100 10分钟177 30天 0.6 20mpa 单组分环氧导热胶，快速固化，适合酸性或坚固的表面。 mt-125 灰色 30分钟100 8分钟150 14天 2.35 20mpa 快速固化，高粘接强度，适合不同材料的粘接。 mt-220 灰色 30分钟125 10分钟150 7天 4.2 6mpa 高导热率，低应力，可直接与硅粘接。 mt-315 ----- 50分钟125 30分钟150 24hr 11.3 6mpa 超高导热率，适合高功率的应用和不同材料的粘接。 mt-322 灰色 60分钟120 30分钟150 30天 1.7 2mpa 低应力，工作时间长，优异的点胶性能，适合各种大尺寸芯片的封装。 导热脂 我们提供环氧类、有机硅类导热脂，具有高导热率、耐高温、高可靠性、操作简单、适合各种工艺，用于散热器、倒装芯片、变压器、大功率led、电脑封装等有散热要求的应用。 产品 颜色 粘度 (cps) 工作温度 () 导热率 (w/mk) 失重率% 特性 sg-21 白色 1,800,000 200 0.8 0.8 (24hr@200) 高导热率，高绝缘强度，典型应用于功率元件和半导体器件与散热器之间的传热。 tc-208 白色 500,000 80 1.2 20 (1hr@300) 可水洗导热脂，适合小功率及中等功率。 tc-228 蓝色 350,000 200 1.1 1.7 (1hr@300) 耐高温，可用酒精清洗，适合小功率及中等功率。 tc-350 灰色 250,000 (1rpm) 200 4.0 <0.5 (1hr@300) 耐温性好，适用于高速点胶和印刷。 tc-426 灰色 435,000 (300rpm) 200 6.0 <0.5 (1hr@300) 超高导热硅脂，易清洗，可靠性高。 tc-405 灰色 252,000 (300rpm) 200 5.2 <0.5 (1hr@300) 超高导热率硅脂，适合高功率使用。 tc-501 灰色 128,400 - 8.0 nil 超高导热率硅脂，低热阻，无损耗，适合半导体封装。 导热凝胶 我们提供有机硅类导热凝胶，具有常温/低温固化、低应力、高导热率、高可靠性，用于散热片、倒装芯片、变压器、大功率led等有散热要求的应用。 产品 粘度 (cps) 固化条件 工作温度 () 导热率 (w/mk) 特性 mg-100 1,700,000(1rpm) >400,000(10rpm) 1小时100 10分钟150 200 2.1 矿物填充，快速固化，高导热率，低热阻。 mg-121 60,500(20rpm) 75,000(10rpm) 2小时100 30分钟150 60分钟125 200 2.3 极好的抗吸湿性，适合小间隙。 mg-122 85,000(10rpm) 60,000(20rpm) 1小时120 30分钟150 200 2.8 第二代导热凝胶，湿气稳定性好，加速老化性能卓越。 mg-133 128,400(30rpm) 105,900(60rpm) 1小时120 30分钟150 200 3.8 导热凝胶，湿气稳定性好，加速老化性能卓越。 mg-200a/b 45,000(3rpm) 100,000(0.3rpm) 3小时25 20分钟85 200 3.0 双组分，室温固化，低应力。 厚膜材料 超过25年的研发应用经验，可提供高工艺适应性的引线框架粘接银膏，低esr的浸蘸银浆及碳浆，以及icp钽电容应用的银及碳浆材料。 框架粘结 银浆 产品 黏度 mpa.s 固化条件 导电率 (-cm) 特性 6144 5~7kcps 125 15分钟 0.0002 钽电容框架粘结银浆，低esr产品。 6148s 9~11kcps 125 15分钟 0.00035 钽电容框架粘结银浆，低esr产品。 pcc40533 7.5~9.5kcps 150 5分钟 0.0002 钽电容框架粘结银浆，快速固化。 浸蘸 银浆 产品 黏度 mpa.s 固化条件 导电率 (-cm) 特性 2232 350~450 cps 干燥：80 10分钟 固化：150 30分钟 0.0002 热塑性银浆，应用于钽电容，电磁屏蔽。 pc11159 600~700 cps 干燥：150 10分钟 固化：210 30分钟 0.0001

热固性银浆，应用于钽电容，电磁屏蔽，低esr产品。 pcc40514 900~1000 cps 干燥：125 10分钟
固化：220 60分钟 0.0002 热固性银浆，应用于钽电容，电磁屏蔽，极好的流变性能。 k611-14 500 cps
固化：100 10分钟 0.0001 应用于icp钽电容，热冲击性能好，高导电，低esr。 浸蘸 碳浆 产品黏度
mpa.s 固化条件 导电率 (-cm) 特性 circalok6971 - 固化:100 10分钟 0.2
应用于钽电容芯片包封碳浆，成品esr低，也可用做薄膜开关导电碳浆。 低温固化厚膜银导体 我们提
供单组份/双组份的银浆，具有高附着力、低电阻、低温固化的特性，可应用于触摸屏、薄膜开关、熔断
器等产品。 产品 体积电阻 (m /sq/mil) 固化条件 特性 6100 <50 150 30分钟
对陶瓷，玻璃，塑料等都有较好的附着力，也可用于smd等粘结，可钢网印刷。 6103 <25 80 30分钟
可以较低温度固化，应用于多种基板，可用于rfid。 pc10678hv <40 100 30分钟
可以较低温固化，弯折电阻低，典型应用于触摸屏。 6050r 6050h <0.001 -cm 25 24小时 100 30分钟
对多种材质具有极强附着力，可用于模块的导电密性，元器件的粘结等方面。 低温固化可电镀银导体
产品 体积电阻 (m /sq/mil) 固化条件 特性 pcc40228c <40 干燥：80 15分钟 固化：210 30分钟
应用于多种元器件可电镀端浆，具有高附着力，低电阻率。 pcd40397lv <60 干燥：125 10分钟
固化：210 30分钟 用于卡片工电阻及其它元器件，可电镀端浆。 低温固化保护介质 产品 颜色
耐穿击电压 固化条件 特性 pc1088l 绿色 >500v/m 240 30分钟 用于片式电阻及其它smd元器件的保护。
pcd40394 黑色 - - 用于片式电阻及其它元器件的保护。 低温固化电阻浆料 产品 阻值范围 固化条件 特性
8600系列 0.9 -1.1m 210 30分钟 应用于柔性或其他需要低温固化的基材上，而磨擦性能好。